

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年7月1日(01.07.2021)



(10) 国際公開番号

WO 2021/130823 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/301 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2019/050395

(22) 国際出願日: 2019年12月23日(23.12.2019)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人: 昭和電工マテリアルズ株式会社 (SHOWA DENKO MATERIALS CO., LTD.)
[JP/JP]; 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 Tokyo (JP).

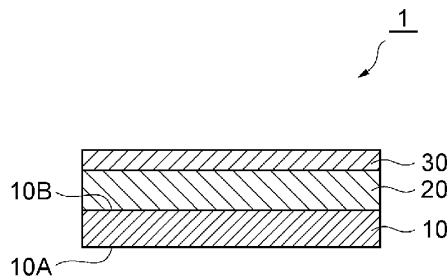
(72) 発明者: 彼谷 美千子 (KAYA Michiko);
〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 日立化成株式会社内 Tokyo (JP). 谷口 紘平 (TANIGUCHI Kohei); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 日立化成株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(54) Title: DICING/DIE-BONDING INTEGRATED FILM, METHOD FOR MANAGING QUALITY OF SAME, AND METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: ダイシング・ダイボンディングー体型フィルム及びその品質管理方法、並びに半導体装置の製造方法



(57) Abstract: A method for managing the quality of a dicing/die-bonding integrated film is disclosed. The quality management method comprises: a first step for preparing a dicing/die-bonding integrated film comprising a base material layer having a first surface and a second surface on a side opposite to the first surface, a tackifier layer provided on the second surface of the base material layer and made of a photo-curable tackifier, and an adhesive agent layer provided on a side opposite to the base material layer of the tackifier layer; a second step for, with respect to the first surface of the base material layer of the dicing/die-bonding integrated film, calculating a load length ratio tp; and a third step for determining the quality of the dicing/die-bonding integrated film using the load length ratio tp as an index.

WO 2021/130823 A1

[続葉有]

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: ダイシング・ダイボンディングー体型フィルムの品質管理方法が開示される。当該品質管理方法は、第1の表面及び第1の表面の反対側の第2の表面を有する基材層と、基材層の第2の表面上に設けられた、光硬化性粘着剤からなる粘着剤層と、粘着剤層の基材層とは反対側に設けられた接着剤層とを備えるダイシング・ダイボンディングー体型フィルムを準備する第1の工程と、ダイシング・ダイボンディングー体型フィルムの基材層の第1の表面について、負荷長さ率 t_p を算出する第2の工程と、負荷長さ率 t_p を指標として、ダイシング・ダイボンディングー体型フィルムの品質の良否を判定する第3の工程とを備える。